

成都超纯应用材料股份有限公司

募集资金具体运用情况

深圳证券交易所：

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将募集资金具体运用情况说明如下：

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，发行人本次拟公开发行人民币普通股不超过 2,546.1539 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例为 25%。实际募集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	半导体设备核心光学零部件产业化项目	34,895.00	34,895.00
2	半导体材料及表面处理产业化项目	31,737.00	31,737.00
3	眉山基地产能扩建项目	20,900.00	17,780.00
4	总部及研发中心建设项目	16,056.00	16,056.00
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		115,588.00	112,468.00

（一）半导体设备核心光学零部件产业化项目

1、项目建设内容

本项目拟围绕半导体设备核心光学零部件的市场需求，依托自身丰富的生产制造经验与技术积累，建设半导体设备核心光学零部件产品生产线。项目计划总投资 34,895.00 万元，项目建设期 3 年，建设地点为四川省成都市。本项目的实施主体为发行人母公司。

2、项目建设的必要性

(1) 响应国内高端产业自主可控发展的战略、把握国产替代市场机遇的需要

光学类零部件作为核心部件，被广泛应用于芯片高端制造、航空航天等重要领域。随着人工智能、大数据等技术的不断进步，以及我国高端制造业的快速发展，国内光学类零部件的市场需求日益增加。长期以来，我国在半导体设备领域光学类零部件方面对进口的依赖度依然较高，近年来欧美国家对我进行先进光刻机出口限制，阻碍我国先进制程芯片制造，进而试图减缓我国 5G、人工智能等新一代信息技术发展。因此，在当前大国博弈、国际竞争加剧、部分国家对我国进行科技封锁的背景下，我国实现光学类零部件制造的自主可控需求迫切。国家战略持续向高端制造、自主可控倾斜。企业需加快核心技术的突破，提升国产替代的进程。

作为我国掌握半导体设备领域光学类零部件制造加工核心技术的科技型企业，公司有必要加大精密光学器件产品生产能力，拓展精密光学器件产品类别，以顺应我国光学产业国产替代发展趋势，为实现该领域自主可控助力。

通过本项目的实施，公司将新建光学类零部件生产基地，打造半导体设备领域光学类零部件的生产能力。一方面，满足市场对高端产品的需求从而把握住国产替代机遇进入新的发展阶段，另一方面顺应我国半导体设备领域光学类产品产业自助可控迫切需求，为下游高端制造等领域提供核心光学类零部件支持。

(2) 推动公司核心技术延展应用，夯实业务持续发展的需要

公司深耕特殊涂层工艺及其关联技术和材料领域近二十年，凭借在半导体设备核心零部件领域的技术积累和持续创新，自主研发了多种特殊涂层工艺技术，实现特殊涂层零部件国产突破，针对不同的运用场景能够实现超低颗粒和微量元素污染控制、超高反射率或透射率、超高平整度面型精度、耐辐照抗辐射、高低温冲击性等关键性能。

通过本项目的实施，公司可充分发挥自身的技术优势，扩大公司半导体设备领域光学类零部件产品生产能力，持续促进核心工艺技术在光学领域的延伸应用；

进一步增强公司市场竞争能力，夯实公司业务长远发展的基础。

(3) 满足半导体设备领域光学类零部件领域日趋增长的市场需求，丰富公司核心产品种类、拓展新的利润增长点需要

近年来，随着光学产品市场不断发展，光学产品类别日益丰富，光学类零部件被广泛应用于下游行业。其中，光学类零部件在半导体、工业测量、激光雷达、航空航天等新兴领域的应用在迅速提升；尤其在半导体制造领域，光学类零部件作为核心部件被广泛应用于光刻机、量测设备等半导体生产重要设备，比如匀光镜头、反射镜及其他辅助镜头等对光刻工艺、半导体产品检测作用重大。半导体设备领域光学类零部件市场增长态势良好、行业前景广袤。

通过本项目的实施，一方面可以通过丰富公司光学产品种类，生产多样化的精密光学器件产品，满足下游市场日益增长的多元化光学产品需求；另一方面，公司产品类别将更加丰富，产品结构将得到持续优化，为公司拓展新的收入来源及利润增长点。

3、项目建设的可行性

(1) 广阔的下流应用市场需求为项目实施提供充足的产能消化空间

随着光学类零部件在高分辨率成像、激光加工、传感识别等领域需求持续提升，国内企业加速推进高端制造能力和材料技术升级。根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）数据，预计未来几年，中国精密光学市场将在技术进步与国产替代双重驱动下持续扩大，市场规模有望在全球份额中进一步提升，促使中国工业级精密光学市场市场规模高速增长，据 VDMA 预测数据，2027 年我国工业级精密光学加工市场规模达到 1,555 亿元，2022-2027 年复合增长率达 15.57%。同时，随着我国光学企业技术水平的提升和产业链的完善，光学产品行业的国产化替代进程不断加速，国产光学类零部件产品市场需求日趋增加。

光学产品市场良好的发展态势，拉动产业链光学类零部件产品市场需求的增长，为本项目的实施提供了良好的外部市场条件，有利于本项目新增产能的消化。

(2) 先进的技术与生产工艺为项目实施提供技术基础

公司深耕特殊涂层工艺及其关联技术和材料领域，作为国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家重点研发计划课题承担单位以及四川省企业技术中心，公司持续不断加大研发投入，建立了覆盖关键设备自研改造、涂层材料制备改性、特殊涂层工艺开发、表面精密加工、特种金属和非金属材料精密成型、精密清洗及成品检测的全工艺链条自主可控制造体系。

半导体特殊涂层技术具备通用性、可拓展性与应用延展性，可广泛应用于高要求、高水平的表面处理产品领域；光学类零部件产品生产核心技术主要围绕膜层材料、镀膜等表面处理展开，与半导体特殊涂层核心设备及工艺相通、通用性程度高，也使得公司在生产光学产品时具备较强的工艺技术迁移利用能力。

与此同时，公司经过多年经验积累与技术积淀，拥有了丰富的工艺控制经验与先进的设备研制能力，可依据不同器件产品生产的需要进行定制化的工艺开发及设备配置，可为公司生产新产品所需的设备改造、工艺升级打下坚实的基础。

公司先进的技术研发实力、丰富的工艺优化等生产经验，可保障公司在工艺技术拓展应用过程中，及时开发高质且稳定可靠的产品，为项目的顺利实施提供技术支撑。

(3) 丰富的行业经验与运营体系为项目实施提供有力保障

公司核心技术人员均拥有多年特殊涂层等领域的工作经验，具有深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力，能够根据下游市场需求动态及时进行产品的前瞻研发。公司具备良好的产业基础与丰富的行业经验，能够准确把握行业宏观走势，迅速响应市场多样化和定制化的需求。

同时，通过自建洁净车间和自研高精度加工设备，公司实现了特殊涂层零部件的规模化生产，关键工序自动化率显著提升。在质量控制方面，公司严格执行半导体行业标准，建立覆盖原材料入厂、生产过程监控及成品出厂检验的全流程质控体系，确保材料纯度、致密度等核心指标满足客户严苛要求。丰富的生产经营为公司的经营战略的实施提供了良好的管理支持。

4、项目投资概算

本项目预计总投资为 34,895.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例
1	土地投资	900.00	2.58%
2	建设投资	10,356.00	29.68%
3	设备投资	18,349.00	52.58%
4	软件投资	50.00	0.14%
5	预备费	1,440.00	4.13%
6	铺底流动资金	3,800.00	10.89%
合计		34,895.00	100.00%

5、项目实施进度

本项目建设期共计 3 年，分五个阶段实施，具体进度安排如下：

项目	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土地购置												
工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
试运营及投产												

6、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已在四川省成都市双流区发展和改革局完成固定资产投资项目备案，项目代码：川投资备【2504-510122-04-01-602785】FGQB-0215 号。

7、募集资金运用涉及的环保情况

本项目建成后主要进行半导体设备核心零部件的生产，不属于重污染行业，项目营运过程中产生的主要污染物有生产废气、生产废水、噪声和固体废物，在设备采购中已安排采购配套环保设备。项目实施过程中公司将采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准。

截至本招股意向书签署日，已获得成都市双流生态环境局下发的环评批复

《关于成都超纯应用材料股份有限公司算力及车规级芯片用半导体零部件项目（一期）环境影响报告表的批复》（成双环承诺环评审[2025]44号）。

8、募集资金运用涉及土地使用权情况

截至本招股意向书签署日，公司已取得该募投项目用地的权属证书，编号为“川（2026）双流区不动产权第 0008399 号”。

（二）半导体材料及表面处理产业化项目

1、项目建设内容

本项目拟通过建设现代化、购进先进生产设备等，打造先进半导体材料及表面处理基地，用以支持半导体刻蚀设备零部件产能建设。项目计划总投资 31,737.00 万元，项目建设期 3 年，建设地点为四川省成都市。本项目的实施主体为发行人母公司。

2、项目建设的必要性

（1）保障半导体核心设备生产需求，深化半导体产业自主可控生产国家战略的需要

由于行业壁垒高、国内起步较晚，全球半导体零部件供应链依然由日本、欧美等海外企业占据绝对主导地位，而国内半导体零部件整体国产化率较低，特别是高端领域国产替代需求极为迫切。随着国外对中国半导体产业的技术封锁持续加码，技术及设备出口的管控范围和“实体清单”范围进一步扩大，围绕半导体产业开展的地缘政治竞争日趋激烈，中国半导体产业全产业链的自主可控需求已迫在眉睫。国产替代与自主可控将在举国体制下快速发展，这为本土半导体设备厂商提供了难得的发展机遇期。

公司聚焦半导体设备核心零部件领域，自主研发先进的特殊涂层工艺，能够在半导体刻蚀等多个工艺环节提供满足下游厂商需求的半导体零部件产品，并经过头部刻蚀设备厂商的多道严格的检验、认证程序，最终进入到北方华创、中微公司、新凯来等国内半导体设备龙头企业的供应体系。同时，公司参与到客户先进制程的研发，根据客户需求实现生产工艺的改进以及产品的迭代，从而为我国

刻蚀等半导体设备的国产化提供重要支持。

通过本项目的实施，公司将建设半导体材料及表面处理基地，为我国半导体刻蚀设备等领域厂商提供高性能零部件产品。一方面，本项目有助于公司进一步增强产品优势、促进产品迭代，从而进一步提高公司核心产品的综合竞争力。另一方面，有助于深化公司在半导体刻蚀零部件领域的业务布局，及时把握集成电路产业快速发展和半导体零部件国产替代的良好机遇，助力半导体产业自主可控生产的战略持续推进。

（2）扩大刻蚀设备零部件产能，满足下游客户快速发展的需要

半导体刻蚀设备结构复杂、工序流程繁琐，所含零部件种类多样，包括反应腔本体、静电卡盘、冷泵、分子泵、真空泵、阀门、匀气盘等，刻蚀工艺要求零部件需具备高精度、强稳定、耐腐蚀的性能，因此，刻蚀设备厂商对零部件企业的生产能力要求较高。随着我国半导体产业的发展，庞大的市场需求量促使刻蚀设备厂商扩大产能增强供给，因此对掌握刻蚀设备零部件生产能力及加工技术的厂商供应能力提出更高要求。

公司凭借领先的特殊涂层工艺技术，建立了介质窗、喷淋头、喷嘴、刻蚀环等数十种机械类和光学类半导体特殊涂层零部件的多元化产品体系，得到了北方华创、中微公司等国内半导体设备龙头公司的认可，并实现长期稳定合作，为公司业务扩展提供重要支撑。

随着客户业务订单量的持续增长，公司产能瓶颈逐渐显现；基于现有条件公司产能提高空间十分有限，产能的受限导致公司订单消化能力减弱。同时，当前产能不仅限制了公司面向客户规模化、多样化需求与及时供货的能力，且设备高度饱和运转也不利于公司生产满足客户更高要求的产品。因此，为满足不断增长的市场需求和公司发展需要，公司亟需扩大现有产品的产能，提高生产效率。

通过本项目的实施，公司将通过购置先进的生产设备、改进生产场地、优化现有产品工艺等方式，提高半导体特殊涂层零部件产品的产能，并增强产品迭代能力、生产速度，从而提高产品生产能力与订单消化能力、产能与下游客户需求的匹配性，为公司进一步扩大生产规模、实现稳定发展奠定基础。

（3）匹配我国半导体先进制程发展，提升自身技术水平的需要

海外特殊涂层零部件厂商因避免技术泄密、国外政府限制等原因，在中国大陆建厂引入以阳极氧化、大气等离子喷涂技术为主的产品，均未将最先进的特殊涂层技术引进中国大陆。目前，国内厂商普遍采用阳极氧化等表面处理技术，在设备零部件外表面形成氧化物保护层，该方法仅适用于成熟制程。随着芯片制造的先进制程工艺线宽不断迭代，从 14nm 向 7nm、5nm 及以下节点持续突破，晶圆对颗粒污染和微量元素污染的容忍度呈指数级降低——纳米级别的颗粒剥落即可能造成微观电路短路、断路或功能失效，直接导致芯片良率大幅下滑。尤其在先进制程需通过数十次刻蚀、薄膜沉积等工序构建复杂微观结构的背景下，反应腔内零部件表面的颗粒剥落的累积风险显著上升。因此在多样化的反应气体、极端温度波动及高频离子轰击等严苛工况下，避免介质窗、喷淋头、刻蚀环、内衬等距离晶圆最近的核心零部件产生颗粒剥落直接造成晶圆良率下降，已成为保障先进制程稳定量产、维持晶圆高良率的关键前提。研制更耐腐蚀、更耐高温冲击的特殊涂层零部件是集成电路制造向更先进制程迭代的必然发展路线。

因此，为追赶国际先进半导体制程步伐，国内企业在关键技术、核心材料、生产工艺等方面坚持创新，不断开展特色工艺设备研发，聚焦细分领域，实现局部创新，逐步实现以点带面的突破式发展。中微公司与北方华创作为国内刻蚀设备的龙头企业，设备覆盖先进制程，引领我国刻蚀设备从实现国产替代到逐渐具备全球竞争力。随着客户在先进制程领域持续投入，公司需要结合客户需求进一步改进表面处理工艺，实现所供产品的技术参数、性能指标满足先进制程需要，从而为我国先进刻蚀设备的发展做出贡献。

通过本项目的实施，公司将引入先进的生产制造设备，生产高性能刻蚀设备零部件，满足市场对高端刻蚀设备的需求。本项目有助于增强公司的机械加工能力及技术工程能力，改进表面处理先进工艺，进一步提高自身的技术水平，从而为国内半导体刻蚀设备企业供给高精度、高可靠关键零部件提供有利的技术支持。

3、项目建设的可行性

(1) 广阔的下游市场需求与优质的客户资源为项目实施提供产能消化条件

半导体设备是支撑半导体产业发展的基石，设备性能和先进性直接影响半导体产品制造的品质、工艺效率、良率和先进半导体芯片等的产业化应用。近年，全球半导体设备市场规模逐步扩张。根据 SEMI 数据显示，全球半导体设备销售额从 2019 年的 596 亿美元增长至 2024 年的 1,171 亿美元，2019-2024 年均复合增长率为 14.46%。2023 年受全球半导体产业布局的影响，全球半导体设备市场规模短暫停滞增长，2024 年重新恢复增长势能，预计 2025 年和 2026 年市场规模持续增长至 1,255 亿美元和 1,381 亿美元。国内半导体设备行业在下游快速发展的推动下保持快速增长的趋势。根据 SEMI 数据，2024 年中国大陆半导体设备市场规模接近 500 亿美元，占全球半导体设备市场份额超过 40%。

经过多年的经营积淀，在设备厂商零部件配套市场，公司产品成功进入北方华创、中微公司、新凯来、鲁汶仪器等半导体制造设备龙头厂商的供应链体系，共同攻克各类设备精密零部件的特种工艺和重难点问题，推动半导体先进制造工艺的自主可控和创新迭代。在晶圆厂零部件替换市场，公司与中芯国际、长江存储等境内龙头晶圆代工企业、存储芯片企业及 IDM 厂商建立了稳定的合作关系，公司各类产品还已陆续送样至英特尔、德州仪器、青岛芯恩、士兰微、卓胜微、格科微、合盛硅业、隆基绿能等下游客户，用于 LAM、TEL、AMAT 公司的各类半导体设备零部件替换，持续满足市场存量设备使用过程中的零部件更换需求。

公司基于自身的技术优势，为客户提供了稳定、高品质的产品服务，且与客户达成了稳定的合作关系，未来订单充足，为本项目的实施提供产能消化条件。

(2) 深厚的技术积淀与先进的技术工艺为项目实施奠定坚实基础

公司特殊涂层技术破解国产设备性能瓶颈，促进国产先进制程迭代升级。公司运用自主研发的多项特殊涂层工艺技术，实现特殊涂层零部件国产突破，弥补了我国晶圆制造刻蚀组件薄膜的关键核心技术的缺失。

公司凭借技术优势和量产能力，在国产半导体核心零部件的刻蚀、光刻、薄膜沉积和退火设备等重要细分领域持续扩大市场占有率，保持了较为明显的竞争

优势，这助力了公司后续在离子注入、扩散、键合和先进封装等领域的产品验证和市场开拓。与此同时，公司经过多年经验积累与技术积淀，拥有了丰富的工艺控制经验与先进的设备研制能力，可依据不同器件产品生产的需要进行定制化的工艺开发及设备配置，为公司生产新产品所需的设备改造、工艺升级打下坚实的基础。

公司先进的技术研发实力、丰富的工艺优化等生产经验，可保障公司在工艺技术拓展应用过程中，及时开发高质且稳定可靠的产品，为项目的顺利实施提供技术支撑。

（3）丰富的生产经验，为项目实施提供稳定运营保障

公司自设立以来以技术为先导，持续推动公司内部运营体系建设，陆续建立完善内部管理体系，从而更好地满足技术迭代快、产品要求高、响应速度快的产业特征。目前，公司建立了覆盖关键设备自研改造、涂层材料制备改性、特殊涂层工艺开发、表面精密加工、特种金属和非金属材料精密成型、精密清洗及成品检测的全链条自主可控制造体系。通过自建洁净车间和自研高精度加工设备，公司实现了国产半导体设备特殊涂层零部件的规模化生产，关键工序自动化率显著提升。在质量控制方面，公司严格执行半导体行业标准，建立覆盖原材料入厂、生产过程监控及成品出厂检验的全流程质控体系，确保材料纯度、致密度等核心指标满足客户严苛要求。

因此，公司丰富的生产经验与成熟健全的运营体系，为公司项目实施、产品拓展提供管理支持，为本项目的顺利实施提供了有力的运营保障。

4、项目投资概算

本项目预计总投资为 31,737.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例
1	土地投资	900.00	2.84%
2	建设投资	10,356.00	32.63%
3	设备投资	16,291.00	51.33%
4	软件投资	50.00	0.16%

序号	项目名称	金额	比例
5	预备费	1,340.00	4.22%
6	铺底流动资金	2,800.00	8.82%
合计		31,737.00	100.00%

5、项目实施进度

本项目建设期共计 3 年，分五个阶段实施，具体进度安排如下：

项目	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土地购置												
工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
试运营及投产												

6、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已在四川省成都市双流区发展和改革局完成固定资产投资项目备案，项目代码：川投资备【2504-510122-04-01-602785】FGQB-0215 号。

7、募集资金运用涉及的环保情况

本项目建成后主要进行半导体设备核心零部件的生产，不属于重污染行业，项目营运过程中产生的主要污染物有生产废气、生产废水、噪声和固体废物，在设备采购中已安排采购配套环保设备。项目实施过程中公司将采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准。

截至本招股意向书签署日，已获得成都市双流生态环境局下发的环评批复《关于成都超纯应用材料股份有限公司算力及车规级芯片用半导体零部件项目（一期）环境影响报告表的批复》（成双环承诺环评审[2025]44 号）。

8、募集资金运用涉及土地使用权情况

截至本招股意向书签署日，公司已取得该募投项目用地的权属证书，编号为“川（2026）双流区不动产权第 0008399 号”。

（三）眉山基地产能扩建项目

1、项目建设内容

本项目拟依托眉山基地现有场地，通过购入先进生产设备，生产半导体扩散、退火、外延等设备配套零部件以及红外光学零部件，进一步扩大眉山基地产品生产能力。项目计划总投资 20,900.00 万元，其中使用募集资金 17,780.00 万元；项目建设期 3 年，建设地点为四川省眉山市。本项目的实施主体为发行人全资子公司眉山超纯。

2、项目建设的必要性

（1）强化半导体零部件工艺能力，提高产业国产化水平的需要

半导体制造工艺中，退火、扩散、外延等环节的工艺环境较为恶劣，工艺设备零部件面临腐蚀、高温等因素影响，导致零部件使用寿命下降并产生诸多杂质，提高生产成本的同时也影响晶圆品质。精密涂装工艺能够将氧化钼、SiC 等陶瓷粉体材料涂覆在退火及扩散工艺设备的真空腔体内部核心零部件表面，防止工件释放污染物并增加工件使用寿命。在半导体制程进一步提高的背景下，退火及扩散等环节对污染物、颗粒物等要求进一步严苛，半导体特殊涂层由于其技术壁垒高、国产化率低，成为影响现有晶圆生产的因素之一。

公司在刻蚀设备领域已经与中微公司、北方华创等开展深入的合作，为其提供零部件特殊涂层服务，在其刻蚀设备中形成广泛的配套。在此过程中，公司不断积累适用于不同材料、应用不同工艺的特殊涂层技术，持续拓宽特殊涂层技术在半导体制造领域的应用。而中微公司、北方华创等企业也不断根据半导体设备的国产化需求，对产品系列进行延伸，实现在外延、退火等工艺领域的设备产品布局，进一步扩大对不同应用场景的特殊涂层零部件的市场需求。作为其密切的零部件供应商，公司有必要根据半导体生产工艺需求，针对退火、扩散、外延等工艺设备环节的恶劣工况，强化特殊涂层工艺的产业化落地能力，突破半各类半导体零部件制造壁垒，从而助力解决半导体特殊涂层零部件的卡脖子问题。

通过本项目的实施，公司将依托现有精密特殊涂层技术，针对不同材料和应用的半导体设备零部件产品进行配套产能建设。公司将在更多半导体设备环节实

现高技术、高附加值的关键零部件国产化自主配套，本项目有助于满足我国半导体设备厂商从成熟制成迈向先进制程的发展需求，助力我国半导体产业的国产化历程。

(2) 延伸半导体核心设备零部件应用领域，满足半导体市场持续增长的需要

随着全球半导体产业链向我国转移，我国半导体产业保持高速发展，芯片制造各个环节的设备市场需求旺盛，为国内半导体零部件企业提供良好发展机遇。在此背景下，半导体零部件企业扩产意愿强烈。半导体制造工艺流程包括薄膜沉积、涂光刻胶、曝光显影、刻蚀、离子注入等多个核心环节，涉及零部件种类较为广泛。受终端芯片市场拉动，半导体设备应用对配套零部件形成更大的需求。

经过多年发展，公司不断深化半导体设备核心零部件领域的研究，掌握了先进的特殊涂层工艺等表面处理技术，除在刻蚀设备方面实现规模化配套外，也逐步渗透至外延、退火等半导体关键设备领域，实现产品及技术在半导体产业链内的有效延伸。随着我国芯片产品市场需求的持续释放，半导体各工艺环节的设备需求也逐步增长，市场要求具备配套零部件企业扩大产品供应能力，因此公司需要持续扩充在退火、扩散、外延等设备领域的产品供应，把握市场快速发展带来的增长机遇。

通过本项目的实施，公司将充分发挥特殊涂层工艺等表面处理技术的先进性，对现有眉山生产基地进行升级改造。本项目有助于公司提高 RTP 反射板、晶舟扩散器件、外延石墨托盘等产品产能，增强公司产品生产能力与订单消化能力，为公司进一步扩大生产规模、实现稳定发展奠定基础。

(3) 拓展特殊涂层产品供应类型，增强公司市场竞争力的需要

在新一代武器装备系统中，光学仪器已经成为发现敌人、瞄准敌人、攻击敌人的高级传感系统，跻身于先进武器装备的行列，如红外成像技术、微光夜视技术、光电火控技术、光电对抗技术、精确制导技术、激光雷达技术在国防建设中均发挥了重要作用。由于国防科技场景环境复杂，对光学的产品透光性、防尘防雨蚀、抗反射等方面具有较高要求，因此需要通过特殊涂层技术强化产品属性，

提高武器装备作战能力和效率。

公司在服务半导体设备厂商的过程中，不断拓展特殊涂层的适用性研究，与国内多家光学设备研究院所形成合作，助力光学产品在国防装备领域的推广应用。随着我国武器装备技术实力的快速提升，新型产品开发及产业化应用不断加快，国防领域对各类光学产品的配套需求持续增长，作为具备较强特殊涂层技术的企业，公司有必要强化自身在国防科技市场的技术释放能力，通过扩大光学产品特殊涂层服务助力我国武器装备迭代升级，与此同时也进一步丰富和优化公司产品结构，推动公司业务更加健康发展。

通过本项目的实施，公司将实现配套国防科技光学产品的特殊涂层及零部件加工制造能力。本项目有助于公司拓展核心特殊涂层技术的应用领域，并深化在国防科技领域的应用拓展，为国家国防工业发展贡献力量，同时将推动公司经营规模持续扩大，不断强化公司市场竞争力。

3、项目建设的可行性

（1）广阔的下游市场需求与优质的客户资源为项目实施提供产能消化条件

近年来，在国家政策支持和资金持续扶持引导下，国内晶圆厂商纷纷扩产，带动国内半导体设备市场需求爆发式增长。同时，随着各类电子终端的芯片需求及智能化、网联化的发展，半导体设备行业规模保持大幅度的正增长。此外，先进制程发展、工艺流程改进，半导体设备也迎来新需求。根据 SEMI 数据，2024 年中国大陆半导体设备市场规模接近 500 亿美元，占全球半导体设备市场份额超过 40%。

凭借产品竞争力优势和快速响应能力，公司核心客户收入持续保持稳定，客户黏性不断增强，与北方华创、中微公司、新凯来、鲁汶仪器等国产设备龙头建立深入合作；随着公司影响力不断提升，在新客户开发方面也卓有成效，产品已通过中芯国际、长江存储等头部晶圆厂认证，并批量供货，用于替代国际厂商原装零部件。此外，公司积极拓展核电站泵阀用耐辐照材料及暗室材料等新兴领域，为可持续增长注入新动能。此外，公司还积极投身国家重大工程项目，并与国内重点科研单位共同研制精密光学器件，保障国防科技生产。

未来 5G、物联网、人工智能等新技术驱动下，半导体设备市场整体将呈现快速发展趋势，且公司与客户达成了稳定的合作关系，未来订单充足，为本项目的实施提供产能消化条件。

（2）深厚的技术积淀与先进的技术工艺为项目实施奠定坚实基础

公司经过多年的经验积累与技术积淀，拥有了丰富的工艺控制经验与先进的设备研制能力，可依据不同器件产品生产的需要进行定制化的工艺开发及设备配置，为公司生产新产品所需的设备改造、工艺升级打下坚实的基础。

随着国内半导体先进制程工艺微缩化迭代，半导体设备反应腔室内部面临愈发严苛的工艺制备环境，高密度等离子体、极端温度波动及高频离子轰击对反应腔内零部件的抗侵蚀性能和稳定性提出指数级增长的技术要求。公司应用自主研发的多项特殊涂层工艺，在介质窗、喷淋头、喷嘴、刻蚀环、内衬、静电卡盘等核心零部件表面构筑纳米级致密防护层，实现等离子体耐受性、超低颗粒和微量元素污染控制等关键性能突破，有效保障半导体先进制程设备在超高等离子侵蚀、超高温、超高真空环境下的稳定运行，维持晶圆的高良率。目前，公司已具备刻蚀、光刻、量检测、退火、薄膜沉积、硅外延等多种类半导体设备零部件的配套能力，是国内极少数 5nm 及以下制程半导体刻蚀设备核心零部件的供应商。

公司先进的技术研发实力、丰富的工艺优化等生产经验，可保障公司在工艺技术拓展应用过程中，及时开发高质且稳定可靠的产品，为项目的顺利实施提供技术支撑。

（3）丰富的生产经验，为项目实施提供稳定运营保障

由于半导体设备核心零部件的制造需要公司长期进行摸索，生产过程中对于温度、气流等的控制需要多年的生产经验作为支撑，公司深耕该领域近二十年，持续推动公司生产管理等建设。通过自建洁净车间和自研高精度加工设备，公司实现了国产半导体设备特殊涂层零部件的规模化生产，关键工序自动化率显著提升。

凭借多年的研发技术和严谨的生产管理，坚持以行业标准审视自身发展，不断研发创新，解决了客户许多高难度的需求，不断为半导体和红外光学等领域提

供高质量产品，积累了成熟的生产经验，为公司产品品质的均一性、稳定性创造了良好条件。

因此，公司丰富的生产经验与成熟健全的运营体系，为公司项目实施、产品拓展提供管理支持，为本项目的顺利实施提供了有力的运营保障。

4、项目投资概算

本项目预计总投资为 20,900.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例
1	建设投资	1,600.00	7.66%
2	设备投资	15,920.00	76.17%
3	预备费	880.00	4.21%
4	铺底流动资金	2,500.00	11.96%
合计		20,900.00	100.00%

5、项目实施进度

本项目建设期共计 3 年，分四个阶段实施，具体进度安排如下：

项目	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
试生产												

6、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已在四川省彭山区经济和信息化局完成固定资产投资项目备案，项目代码：川投资备【2506-511422-07-02-115013】JXQB-0448 号。

7、募集资金运用涉及的环保情况

本项目建成后主要进行半导体设备核心零部件的生产，不属于重污染行业，项目营运过程中产生的主要污染物有生产废气、生产废水、噪声和固体废物，在设备采购中已安排采购配套环保设备。项目实施过程中公司将采取相应措施对污

染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准。

截至本招股意向书签署日，已获得眉山市彭山生态环境局下发的环评批复《关于眉山超纯应用材料科技有限公司眉山基地产能扩建项目环境影响报告表的批复》（眉市环建彭[2025]21号）。

8、募集资金运用涉及土地使用权情况

本项目建设地点位于四川彭山经济开发区创和路西段6号，已取得《不动产权证书》（川2024彭山区不动产权第0007172号）。

（四）总部及研发中心建设项目

1、项目建设内容

本项目拟在整合公司现有资源的基础上，增强信息化建设、升级公司的研发体系，打造公司总部基地与研发中心。项目计划总投资16,056.00万元，项目建设期3年，建设地点为四川省成都市。本项目的实施主体为发行人母公司。

2、项目建设的必要性

（1）增强公司运营管理效率及公司研发实力，提升公司的综合竞争力水平的需要

作为半导体设备关键核心技术和性能的实现载体，半导体设备零部件为满足不同半导体设备的特殊应用功能，其研发、设计和生产过程需与下游应用需求高度融合。因此，半导体设备零部件企业一方面需积累丰富的上下游产业经验、大量技术诀窍和实践经验，充分理解下游应用环境特点、技术工艺参数需求等，制造出性能优异且能快速适配客户需求并通过严苛验证的零部件；另一方面又要通过下游应用端的经验和技术积累，实时跟进并深刻理解下游应用端的升级迭代需求，具备反向指导前端生产工艺研发并持续升级产品性能的技术实力，从而实现半导体设备零部件的技术升级迭代。

通过本项目的实施，一方面，公司可以通过信息化建设全面提升公司的生产管理水平；另一方面，通过跟踪下游行业发展趋势以及行业技术发展趋势，及时开展新产品、新工艺研发工作，确保公司产品满足时刻变化的市场需求，以便拓

展公司业务领域，增强公司综合竞争力。

（2）促进技术、工艺的持续创新，满足下游市场需求的需要

半导体设备产品表面的特殊涂层直接决定设备品质，进而可以稳定工艺条件和延长产品寿命。随着半导体产品向先进制程演进，产品生产的精细化程度越来越高，器件抗腐蚀性能越来越强，颗粒污染和微量元素污染控制更严苛，对设备器件或工作件表面粗糙度、孔隙率、硬度等提出更高要求，同步需要开发新的涂层技术。

公司核心技术体系以下游市场需求为导向，通过自主研发和技术创新，建立了特殊涂层工艺及其关联技术、特殊涂层材料及陶瓷材料制备技术和生产装备自主化研制技术等三位一体的核心技术矩阵。在特殊涂层工艺及其关联技术方向，公司突破实现了高致密、超低孔隙率、超低微量元素污染特殊涂层的制备工艺，通过对气相沉积、高致密等离子喷涂等表面处理工艺的研发创新，使半导体设备特殊涂层零部件产品的耐等离子侵蚀、抗颗粒污染及微量元素控制等性能达到较高水平，能够先进制程芯片制造需求。在特殊涂层材料及陶瓷材料制备技术方向，公司依托自主研发的高纯特殊涂层材料制备技术、半导体设备零部件用氧化物陶瓷制备技术等材料制备方法，提升特殊涂层零部件的基础材料工艺自主可控性。在生产装备自主化研制技术方向，公司通过设备硬件改造、全新设计以及工艺控制软件自主编程，与公司自身积累的特殊涂层工艺经验实现良好适配，实现设备工艺环境多级气体混合、智能热场调控的创新，以及特殊涂层工艺过程中工艺参数的高精度控制，使产品的加工良率与稳定性大幅度提升。公司需持续加大研发投入，强化先进涂层技术的研发，为客户提供更高品质半导体核心器件，提升公司市场竞争力。

通过本项目的实施，公司将通过打造高水平的研发实验室并配置先进研发设备、新建研发中心，进一步提升公司核心技术研发能力；同时，公司可以进一步提升精密特殊涂层技术，满足市场对半导体领域对更高层性能特殊涂层的需求，同时也可帮助公司构建自身行业技术壁垒，增强产品、技术等方面核心市场竞争力。

(3) 提高研发工作条件，吸引优秀技术人才的需要

半导体核心零部件制造领域属于技术密集型行业，其中特殊涂层技术涉及涂层材料、涂层工艺、涂层设备等多类技术，涵盖材料科学、化学、物理学、机械工程、电子工程等多学科知识，因而对专业技术人才形成大量需求。此外，随着半导体行业技术快速进步，前沿技术不断出现，对半导体特殊涂层技术需求亦持续演变，需要更多高技术研发人员提供智力支持。

公司作为国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家重点研发计划课题承担单位以及四川省企业技术中心，已构建了三十余人的研发团队，能够对公司业务、产品提供技术支持，在半导体设备核心零部件领域持续创新与技术积淀。随着下游半导体行业应用创新和向更高水平发展，公司将面临更多新的市场需求，需要推动特殊涂层等相关技术不断迭代升级。与此同时，特殊涂层等技术方向应用广泛，公司需提升技术适用范围，满足下游多样化需求。因此，公司打造更加强大的技术研发队伍，通过充足的技术研发人员形成对各主要技术方向的研发覆盖，进而推动特殊涂层等核心技术多维度创新和优化升级。

通过本项目的实施，公司将在成都新建总部与研发中心，配置更为先进的研发设备、实验设备与配套软件，技术研发条件将明显提升；同时，吸引、凝聚更多的半导体行业科研人才，夯实公司技术领域智力资源，促进技术实力进一步强化。

3、项目建设的可行性

(1) 强大的技术创新能力，为本项目实施提供了技术支持

公司核心技术体系以下游市场需求为导向，构建了覆盖关键设备自研改造、涂层材料制备改性、特殊涂层工艺开发、表面精密加工、特种金属和非金属材料精密成型、精密清洗及成品检测的全链条技术能力，通过自主研发和技术创新，建立了特殊涂层工艺及其关联技术、特殊涂层材料及陶瓷材料制备技术和生产装备自主化研制技术等三位一体的核心技术矩阵。

公司被认定为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”、荣获“四川省企业技术中心”、“成都新材料企业”等称号。多年的技术探索、积累了丰富的技

术成果和工艺经验，为公司依据半导体市场需求及特殊涂层等技术变化，持续进行生产工艺研发和迭代升级奠定了坚实技术基础，助力公司保持技术竞争优势。

丰富的技术积累与工艺经验，可为公司持续进行技术提升、工艺升级、产品创新打下技术基础，从而也将为本项目实施提供技术支持。

（2）公司丰富的行业经验与客户资源，为项目的实施提供了有利的保障

公司自设立以来，持续在半导体设备核心零部件领域深耕。凭借出色的技术能力与优质的产品服务，公司已进入北方华创、中微公司、新凯来、鲁汶仪器等半导体制造设备龙头厂商的供应链体系，共同攻克各类设备核心零部件的特种工艺和重难点问题；并与中芯国际、长江存储等境内龙头晶圆代工企业、IDM 厂商建立了稳定的合作关系，持续满足市场需求。

公司在刻蚀、光刻、量检测、退火、薄膜沉积等领域取得较为突出的技术优势，在扩散、离子注入、键合和先进封装等领域小批量量产或取得客户验证，在硅外延片领域实现关键零部件产品的技术突破，这助力了公司在半导体设备零部件领域持续开展技术研发、产品验证和市场开拓。

因此，公司依托丰富的行业经验与客户资源，能够准确把握行业宏观走势，迅速响应市场多样化的需求，为项目的实施提供了有利的保障。

（3）公司良好健全的运营体系，为项目的实施提供了有力保障

公司以技术驱动为先导，持续推动公司内部运营体系建设适应技术迭代快、产品要求高、响应速度快等经营特点，陆续建立了成熟、健全的内部管理运营体系，保证研发与生产、市场、管理等各部门动态联动、相互配合。公司建立了覆盖关键设备自研改造、涂层材料制备改性、特殊涂层工艺开发、表面精密加工、特种金属和非金属材料精密成型、精密清洗及成品检测的全链条自主可控制造体系，具备高一致性量产能力。

与此同时，公司主要经营团队拥有丰富的特殊涂层零部件生产经验，为公司的经营战略的实施提供良好的管理能力支持。现阶段，公司已建立了成都、眉山生产制造基地，积累了丰富的项目建设与运营管理经验；为公司发展赋能进入快速发展通道。

因此，公司成熟健全的管理体系和强大的运营能力，为公司项目建设、研发等方面的拓展提供管理支持，为本项目的顺利实施提供了有力的运营保障。

4、项目投资概算

本项目预计总投资为 16,056.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例
1	土地投资	450.00	2.80%
2	建设投资	5,685.00	35.41%
3	设备投资	4,768.00	29.70%
4	软件投资	298.00	1.86%
5	预备费	520.00	3.24%
6	研发费用	4,335.00	27.00%
合计		16,056.00	100.00%

5、项目实施进度

本项目建设期共计 3 年，分六个阶段实施，具体进度安排如下：

项目	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土地购置												
工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
试运营及投产												

6、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已在四川省成都市双流区发展和改革局完成固定资产投资项目备案，项目代码：川投资备【2504-510122-04-01-602785】FGQB-0215 号。

7、募集资金运用涉及的环保情况

本项目建成后主要进行半导体设备和泛半导体领域核心零部件的研发，不属于重污染行业，项目营运过程中产生的主要污染物较少。项目实施过程中公司将采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准。

截至本招股意向书签署日，已获得成都市双流生态环境局下发的环评批复《关于成都超纯应用材料股份有限公司算力及车规级芯片用半导体零部件项目（一期）环境影响报告表的批复》（成双环承诺环评审[2025]44号）。

8、募集资金运用涉及土地使用权情况

截至本招股意向书签署日，公司已取得该募投项目用地的权属证书，编号为“川（2026）双流区不动产权第 0008399 号”。

（五）补充流动资金项目

1、项目建设内容

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，公司综合考虑行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等，拟使用募集资金中的 12,000.00 万元拟用于补充公司主营业务发展所需要的流动资金，满足公司战略发展和对流动资金的需求。

2、项目建设的必要性

随着公司生产经营规模持续扩大，报告期内，公司营业收入复合增长率达 71.25%。未来，公司业务规模将持续扩大，因而需要充足的流动资金来满足公司日常运营过程中所需的原材料采购、人员工资支出等资金需求。同时，半导体行业属于技术密集型行业，行业技术更新迭代迅速。公司需持续进行新品开发和技术升级，不断加大研发费用和资源的投入。随着公司产品布局、研发力度的持续扩大，公司未来面临一定的流动资金缺口。

本次部分募集资金用于补充流动资金能够有效补充运营资金，满足公司持续研发投入及业务规模扩大的需求，为公司持续经营和发展提供资金保障。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都超纯应用材料股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页）


成都超纯应用材料股份有限公司
2026 年 7 月 23 日